

装置概要



本装置は、ナノ寸法の光である近接場光と、それがもたらすフォノン援用励起過程によって、表面の研磨傷、欠損を選択的に修復する、革新的な表面修復装置です。
写真はRFスパッタリング堆積装置への適用例。

特徴

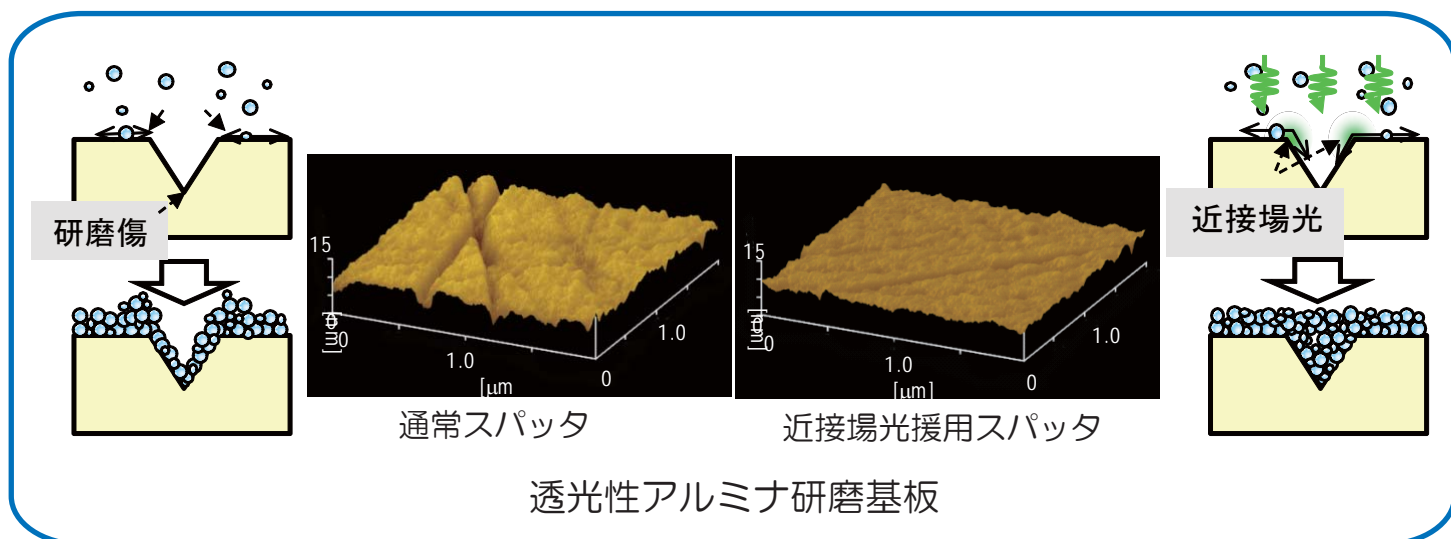
- 原子寸法レベルでの基板表面平坦化が可能
- あらゆる薄膜堆積装置（スパッタリング装置、蒸着装置、MOCVD堆積装置、など）に対して、光を導入することで利用可能

仕様

- 最小表面粗さ（Ra値）：1.0Å（セラミックス基板の場合）
- 一括加工可能面積：30mmφ
- 標準光源：DPSSLレーザ（発光波長532nm、出力光パワー2W）

加工応用例

- 金属、セラミックス、結晶等各種基板
- フォトマスクの欠陥（白欠陥、黒欠陥）修復
- セラミックスレーザ（スパークプラグ）の高効率化



お問い合わせ先